

DX社会の未来を拓く「センシング技術」と「制御」。
その基盤となる 先進デバイス・コンポーネントと
応用システムの専門展示会

SENSOR EXPO JAPAN センサエキスポジャパン2026

出展のご案内

2026.9.16^{WED} ▶ 18^{FRI} 10:00 - 17:00
東京ビッグサイト 東ホール

出展申込は
センサエキスポジャパン
ホームページにて受付中



www.sensorexpojapan.com

 産経新聞社

産経新聞社 事業本部 コンベンション事業部
「センサエキスポジャパン」事務局

〒100-8079 東京都千代田区大手町1-7-2

TEL. 03-3273-6180 FAX. 03-3241-4999 E-mail. sensor@sankei.co.jp

www.sensorexpojapan.com



ご挨拶

センサをはじめとした要素技術は、今、「知覚」と「判断」の融合という新たな段階に進化を遂げています。AIとの融合によるエッジセンシングや、複数の情報を組み合わせるセンサフュージョンは、データ収集・分析の速度と精度を飛躍的に向上させています。さらに、エナジーハーベスティング（環境発電）技術の進化は、センサの設置場所に革命をもたらし、あらゆる産業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を、まさに「現実」へと変えつつあります。

次世代の「DX社会の実現」は、これらの革新的なセンシング技術を核とし、異業種・異分野の“つながり”と連携から生まれます。激しく変動する社会・ビジネスに対応し、さらなる連携・交流を創出する場として、「SENSOR EXPO JAPAN」は進化を続けます。

本展は、DX社会の発展に不可欠なセンサをはじめとした電子部品、デバイス、そしてそれらを活用した最先端のシステムやサービスを集めると同時に、「未来の価値」を披露・発信する場を目指します。

システムの中心技術であるセンサが、社会や人々の暮らしをいかに豊かにするかを具体的に提示・提案するため、現場の課題解決、知識習得、新たな価値創造に繋がる交流を創出することで、産業全体の活性化を側面から支援してまいります。

皆様におかれましては、この機会に是非、貴社技術・製品のPR、商談、そして新たな価値づくりの場として、ご出展をいただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。



開催概要

名 称	SENSOR EXPO JAPAN 2026 (センサエキスポジャパン)
開催趣旨	基盤となるセンシング技術と「デジタルソリューション」の融合をテーマに、ビジネス創出のための人・技術・情報が一同に会します。あらゆる産業のDXと社会の持続的発展に貢献することを目指します。
開催基本方針	①「基盤となるセンシング技術」と「デジタルソリューション」の融合を主導的に示し、あらゆる産業のDXへの貢献を具体的に議論し、実現へ繋げる場を提供します。 ② センサ製品・デバイスの展示に加え、AIやIoTを活用したスマートシティ、産業DX、持続可能な社会といった具体的な応用・未来の暮らしについて深く考える機会を創出します。 ③ 直近の商談機会と並行し、将来のDX社会の実現を見据えた「未来の価値」を披露・発信することで、産学官連携による応用と実現性を高める触媒となります。
会 期	2026年9月16日(水)～18日(金) 10:00～17:00
会 場	東京ビッグサイト 東ホール
入 場	無料(事前登録)
主 催	産経新聞社
特別協賛	一般社団法人次世代センサ協議会
企画協賛	センシング技術応用研究会、一般社団法人電気学会



出展スケジュール

開催までのスケジュール予定(2026年)

4月28日(火)	7月	9月14日(月)	9月15日(火)	12月末頃
出展募集締め切り (順次請求書を送付いたします)	出展者マニュアル、小間レイアウトなどの資料を送付いたします 広報宣伝活動 (案内状発送、WEB更新、広告掲載など)	基礎装飾・出展者搬入 (9:00～18:00)	出展者搬入(9:00～18:00) 16日(水) 開場(10:00～17:00) 17日(木) 開場(10:00～17:00) 18日(金) 開場(10:00～17:00) 撤去・搬出(17:00～)	報告書送付

このような出展者様をお待ちしております

- ① 既存・最新のデバイスやモジュールを、DX・社会課題解決といった応用分野別に提案したい。
- ② 要素技術（圧力・光電など）からコアテクノロジー（MEMS・AI融合）まで、次世代を支える技術に焦点を当てたい。
- ③ 将来の市場動向を見据え、ターゲット未確定の革新的な技術について、新たな協業・応用先を探索したい。

出展要項（企業・団体様へのご要望）

- 「出展対象」に基づき、出展資格を有するすべての企業・団体

出展対象


各種センサ

- 光・電磁波センシング技術 各種光電センサ、イメージセンサ（CMOS/CCD）、LiDAR、レーザ、紫外線、赤外線、光ファイバ、フォトダイオード、フォトリソ技術など
 - 機械・物理センシング技術 圧力、加速度、角速度、回転、変位、衝撃、ひずみ、慣性センサ、フォースセンサ、トルク、微細振動センサ、音波・超音波センサなど
 - 温度・湿度・流体センシング 温度、湿度、熱流、流量、レベル、密度センサ、環境発電（エナジーハーベスティング）センサなど
 - 磁気・電流センシング技術 磁気センサ（MR/GMRセンサ）、電流センサ、磁気抵抗素子、電磁波ノイズ計測など
 - 化学・環境・バイオセンシング ガス、イオン、匂い、味覚、バイオセンサ、環境モニタリングセンサ、非接触生体センシング（脈波、脳波など）、微粒子・花粉センサなど
 - 画像・リモートセンシング イメージセンシング技術、スマートビジョン、機械学習対応センサ、リモートセンシング、バーコードリーダー/OCRなど
 - タッチセンサ、RFID、識別技術 タッチセンサ、RFID、NFC、バーコードリーダー、OCRなどの識別・UI技術
-
- センサ・コア技術と要素部品 センサフュージョン、マイクロマシン・MEMS・NEMS、高機能アクチュエータ、センサ構成部材、部品材料、微細加工技術など
 - 計測・制御・評価システム 高精度計測機器、非接触検査装置、校正・評価システム、品質管理システム、予知保全・リアルタイム診断装置など
 - AI/ソフトウェアとデータソリューション AI/機械学習・データ分析、情報処理アルゴリズム開発、エッジ/クラウド処理技術、デジタルツイン、制御・シミュレーションソフトなど
 - 通信デバイス・ネットワーク IoT/IIoTプラットフォーム、5G/ローカル5G、LPWA、Wi-Fi、Bluetooth、V2X通信、センサネットワークシステムなど
 - 電源・エナジーハーベスティングとノイズ対策 電池・電源技術、環境発電（エナジーハーベスティング）、電磁波・EMC・ノイズ対策技術など
 - 電子機器・その他 電子機器、その他の出展製品および情報

主な来場対象

- 研究開発・技術開発層：センサ/センシング技術のコア技術開発、応用研究、AI・データ解析、システムインテグレーション、規格標準化などに携わる技術者・研究者
- 産業DX・生産現場層：製造DX、スマートファクトリー推進、生産技術、品質管理、設備保全、購買・資材調達などに携わる専門家
- 担当者IoT/社会インフラ応用層：IoT/IIoTサービス開発、新規事業開発、スマートシティ、モビリティ（V2X含む）、医療・ヘルスケア、流通・サービス、社会インフラ（交通・エネルギー）、政府機関の関係者
- 経営・戦略・次世代層：DX推進責任者（CDO、CIOなど）、経営企画、コンサルタント、ベンチャー・スタートアップ、大学・公的研究機関、学生、投資家など

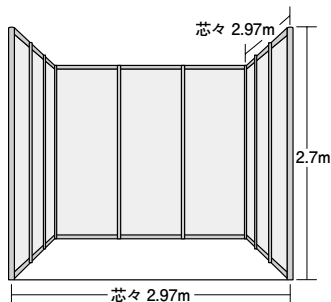
出展者プレゼンテーション

会 場	東京ビッグサイト 東ホール 「SENSOR EXPO JAPAN 2026」内特設会場		
募集対象	SENSOR EXPO JAPAN 2026の出展者 発表内容は原則として発表者の製品・技術または企業イメージ (発表方法は自由ですが、進行は発表者の責任において行ってください)		
運営方法	聴講無料とします。 各テーマごとに先着順受付とし、総入替制とします。(時間厳守) 受付、進行は出展者様で行ってください。(登録や名刺の回収等は自由) 事務局は会場運営全体をサポートします。		
会場設備	受付(机、イス)、聴講席、演台、マイク、PC用プロジェクター、スクリーン等を準備します。 ※インターネット環境の用意はございません。		
P R	「SENSOR EXPO JAPAN」案内状、ホームページなど展示会と連動し、広く発表プログラムを公開します。		
発表時間	1 テーマ20分または40分 ※発表時間・スケジュールは申込締切後、主催者にて決定します。		
参加料金	20分 33,000円(税込) 40分 55,000円(税込) 申込受領後のキャンセルは原則としてお受けできません。キャンセル規定は出展キャンセルに準じます。		
申込締切日	2026年4月28日(火) ※応募多数の場合は事前に締切ります。		

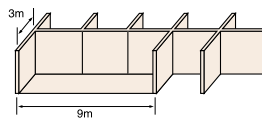
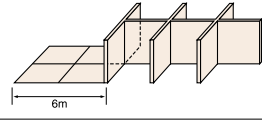
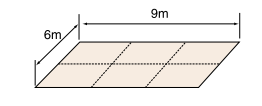
Aタイプ

出展小間規格

1小間=9㎡ (間口3m×奥行3m×高さ2.7m)
側壁・後壁のみ設置 (角小間は側壁なし)



小間形態・装飾高さ制限

小間数	小間形態・装飾高さ制限	小間アレンジ
1～3小間	並列小間のみ (高さ：2.7mまで使用可能) ※但し、1mセットバックした場合のみ4mまで使用可能	
4～5小間	並列小間、ブロック小間より選択可能 (高さ：4mまで使用可能)	
6小間以上	原則独立小間のみ (高さ：5mまで使用可能) ※4面解放となります。並列小間をご希望の場合は事務局までご相談ください。	

出展料

1小間

451,000円 (税込)

パッケージ装飾 (別途有料) ※詳細・申込については、出展者マニュアル (2026年7月末) にてご案内いたします。

小間装飾を簡易に行うためのパッケージプランをご用意いたします。

▶ 1小間タイプ (間口3m×奥行3m)

143,000円 (税込)

社名板 (パラペット) / 受付カウンター (W900×D450×H800) ×1 / 床面カーペット / 電気 (LED蛍光灯20W×1、LEDスポットライト15W×2) / 折りたたみ椅子×1 / 名刺受×1 / 電気幹線工事費及び使用料 (1kW以内) / コンセント (アース付100V・2個口) ×1



(1小間タイプ)

Bタイプ (一定装飾付き) 1社2小間まで

出展小間規格

1小間=間口2.0m×奥行2.0m×高さ2.7m 一定装飾付き (角小間は側壁なし)

出展料 ※出展料、簡易装飾込み

1小間

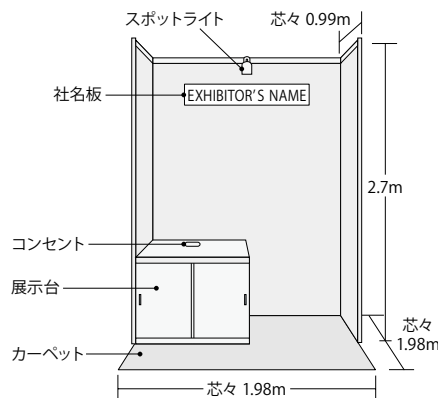
264,000円 (税込)

出展料に含まれるもの：間口2.0m×奥行2.0mの展示スペース、間仕切り (後壁、測壁1m) / 社名板 / 展示台 (W990×D990×H1020) ×1 / 床面カーペット / 電気 (LEDスポットライト15W×1) / 電気幹線工事費及び使用料 (500W以内) / コンセント (アース付100V・2個口) ×1

※展示台は移動可能です。

※備品の追加注文がある場合は、出展者マニュアル (2026年7月末配布予定) をご参照ください。

※上記基本ディスプレイに含まれる備品を使用しない場合も、出展料から差引くことはできませんのでご了承ください。



装飾の高さ制限について

装飾の高さは2.7mまでとします。
(出展製品独自の高さはこの限りではありません)

ホームページ広告

貴社のリンクバナーを公式WEBに開催1か月前から掲載

掲 載 日：2026年8月6日 (木)～9月18日 (金) ※予定

サ イ ズ：W200×H40px GIF形式 ※アニメーションGIF可

料 金：1枠：55,000円 (税込)

原稿締切日：2026年7月23日 (木) ※リンク先指定の上、完成データをご提出下さい。

出展申込はセンサエキスポジャパンHPにて受付中

前回レポート

会 期：2025年9月10日 (水) - 12日 (金) 10:00-17:00

会 場：東京ビッグサイト 西ホール

開催規模

	センサエキスポ	6展合計
企業・団体・大学数	86	462
小間数 (小間)	110	856

※6展合計には、同時開催の5展示会
(測定計測展、総合試験機器展、自動認識
総合展、製造現場DX展、知財・情報フェ
ア&コンファレンス)を含みます。

来場者数

月 日	天気	センサエキスポ	6展合計
9月10日 (水)	晴れのち曇り	1,978名	14,523名
9月11日 (木)	晴れ一時雨	2,203名	16,157名
9月12日 (金)	雲りのち晴れ	2,696名	20,404名
合 計		6,877名	51,084名

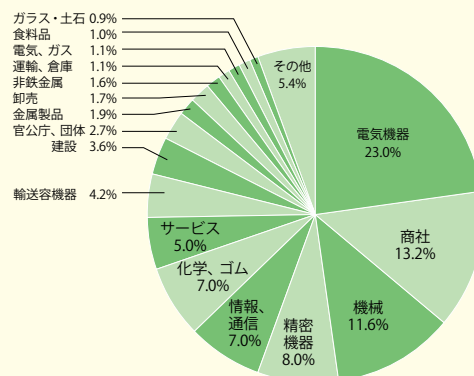
※6展合計には、同時開催の5展示会
(測定計測展、総合試験機器展、自動認識
総合展、製造現場DX展、知財・情報フェ
&コンファレンス)を含みます。

出展者一覧

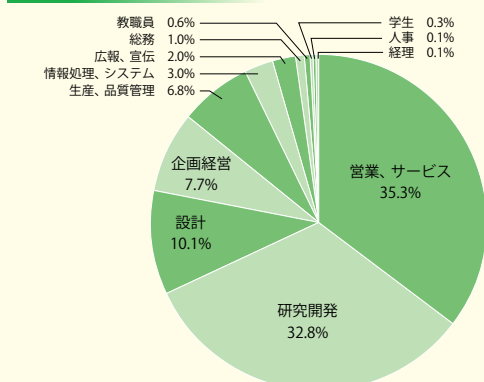
アース株式会社	Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd.	株式会社三ツ波
株式会社アールエスコリア	株式会社昭和真空	緑屋電気株式会社
RV magnetics,a.s.	新光技研株式会社	無錫豪帮高科股份有限公司
愛知製鋼株式会社	SuZhou Leanstar Electronic Technology Co., Ltd.	株式会社メムス・コア
アポロ技研株式会社	スミダコーポレーション株式会社	モバイルコンピューティング推進コンソーシアム (MCPC)
廈門煒映電子科技有限公司	住友金属鉱山株式会社	YAGEOグループ
アルケマ株式会社	株式会社ソフトエージェンシー	株式会社トーキン
アルプスアルパイン株式会社	大毅 (上海) 実業有限公司	株式会社山本電機製作所
株式会社ELT SENSOR	ダイキンファインテック株式会社	リンクステック株式会社
株式会社イージーメジャー	太平貿易株式会社	リンテック株式会社
イナバコム株式会社	太陽誘電株式会社	株式会社和貴研究所
入一通信工業株式会社	株式会社立花デバイスコンポーネント	シン・次世代センサフォーラム
WaferPlus Technology Co., Ltd.	株式会社テクニスコ	地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
英弘精機株式会社	株式会社東京測器研究所	国立研究開発法人産業技術総合研究所
HMTテクノロジーズ合同会社	東洋インキ株式会社	一般社団法人次世代センサ協議会 SUCSコンソーシアム
Edge Foundry Co.,LTD	長瀬産業株式会社	一般社団法人次世代センサ協議会 IoTセンサ技術研究会
エバ・ジャパン株式会社	日本特殊陶業株式会社	一般社団法人次世代センサ協議会 海洋計測センサ技術研究会
FCLコンポーネント株式会社	ノリタケ伊勢株式会社	センシング技術応用研究会
株式会社MKTタイセー	フィガロ技研株式会社	地方独立行政法人大阪産業技術研究所
株式会社エムティアイ	フェイス株式会社	東京科学大学 総合研究院 生体材料工学研究所 センサ医学分野
カシオ計算機株式会社	フジテック株式会社	東京電機大学 金杉研究室
Gichobiznesコミュニケーションズ株式会社	フジトク株式会社	東京電機大学 小松研究室
株式会社クラレ	双葉電子工業株式会社	東北工業大学・室山研究室
株式会社クローネ	株式会社ブラックス	東北大学大学院医学工学研究科芳賀・鶴岡研究室
グローバル電子株式会社	ホットティンガー・ブリュエル・ケアー (HBK)	鳥取大学 工学部マイクロデバイス工学研究室
KOA株式会社	ホルトプラン合同会社	新潟大学マイクロマシン工学研究室
株式会社CyberneX	本多電子株式会社	兵庫県立大学半導体デバイス・プロセス開発支援センター
三栄ハイテックス株式会社	／エコーテック株式会社	
サンテスト株式会社	株式会社マグネア	
Shenzhen Hochuen Technologies Co.,Ltd.	／マグネデザイン株式会社	

来場者分析

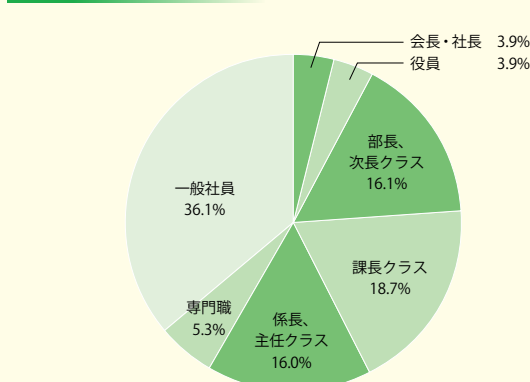
業 種		
電気機器	23.0%	ガラス・土石 0.9%
商社	13.2%	教育 0.9%
精密機器機械	11.6%	医薬 0.9%
精密機器	8.0%	繊維 0.7%
情報、通信	7.0%	紙、パルプ 0.7%
化学、ゴム	7.0%	鉄鋼 0.5%
サービス	5.0%	小売 0.4%
輸送用機器	4.2%	農林、水産 0.2%
建設	3.6%	不動産 0.2%
官公庁、団体	2.7%	その他金融 0.2%
金属製品	1.9%	銀行 0.1%
卸売	1.7%	鉱業 0.1%
非鉄金属	1.6%	保険 0.2%
運輸、倉庫	1.1%	石油、石炭 0.1%
電気、ガス	1.1%	証券 0.0%
食料品	1.0%	



職 種

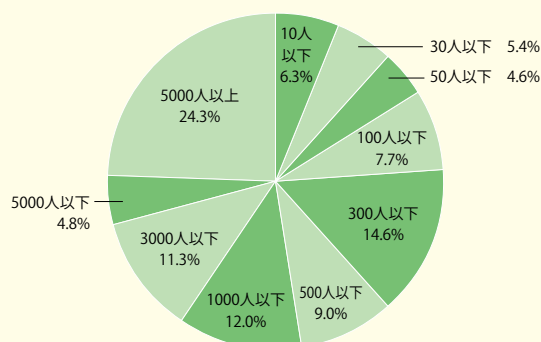


役 職

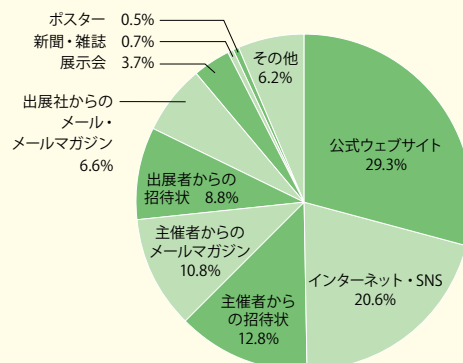


来場者分析

従業員数



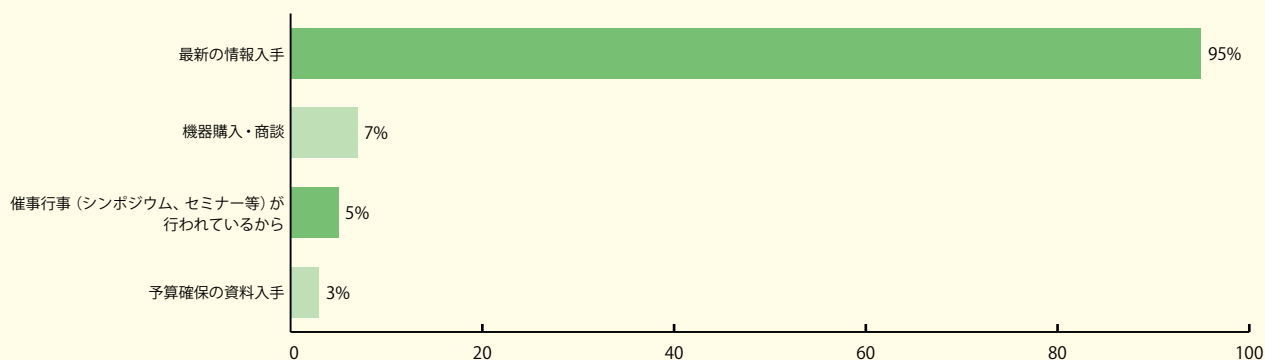
展示会認知経路



【その他の回答内容】

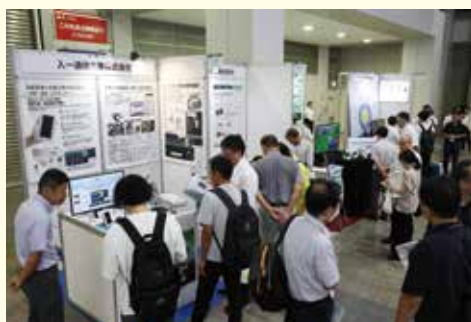
- ・部内での共有
- ・社内、同僚、上司からの紹介
- ・知人からの紹介
- ・ビックサイトイベントスケジュール
- ・取引先からの紹介
- ・物流総合展との同日開催のため
- ・併設展示会のウェブサイト
- ・JETRO
- ・例年参加
- ・2017年から毎回、見学している
- ・1昨年参加

今回の来場目的は？（複数回答可）



【その他の回答内容】

- ・Sler探し
- ・CHAdemoコントローラの開発が可能なベンダーを探しています。
- ・出展者のプレゼン拝聴
- ・出展社様とのお打合せ
- ・出展社表敬訪問
- ・出展する仕入先と面談
- ・取引会社の出展
- ・取引先アテンド
- ・アライアンス企業様発掘
- ・顧客との商談
- ・食品関係のコンサルタント、顧客に紹介
- ・新規事業 用途展開調査
- ・新規開拓
- ・協力・連携先探索
- ・業務改善につながるものがないか
- ・目的のものがあがるか調査
- ・情報収集
- ・業界動向の勉強
- ・業界研究
- ・自社で取り扱える製品の調査
- ・市場調査
- ・顧客理解
- ・顧客開発
- ・技術調査
- ・社内報用取材
- ・勉強のため
- ・見学
- ・センサについて勉強するため。
- ・就活のため
- ・研究企画



SENSOR EXPO JAPAN 2026 同時開催

下記関連展示会との同時開催により、関連応用分野から多数の来場者が訪れます。

JIMA 2026 （第13回総合検査機器展）

製造業を主とした検査・計測・試験・評価・保守に関する専門展示会

主 催：一般社団法人日本検査機器工業会 特別協力：産経新聞社

INTERMEASURE 2026 （第32回計量計測展）

計量計測業界、最大規模。世界の最先端技術が一堂に集まる総合展示会

主 催：一般社団法人日本計量機器工業連合会 特別協力：産経新聞社

地盤技術フォーラム 2026

地盤改良技術展 基礎工技術展 災害対策技術展 土壌・地下水浄化技術展

主 催：産経新聞社／一般社団法人土壌環境センター（土壌・地下水浄化技術展）

共 催：月間「基礎工」（株式会社総合土木研究所）／パイルフォーラム株式会社

FORESTRISE 2026 （第5回次世代森林産業展）

森林産業の活性化に向けて次世代テクノロジー活用を促進する専門展示会

主 催：産経新聞社

2026知財・情報フェア&コンファレンス

特許・実用新案・衣装・商標など知的財産の展示と多数のコンファレンスで構成された総合展

主 催：一般社団法人発明推進協会／一般財団法人日本特許情報機構／産経新聞社